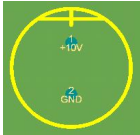


PCB	产品名称	产品型号	版本	页数	制订时间
焊接工艺要求	交流伺服	ISED-F15F1 焊接要求	V8	1/1	2024-6-11

1. 参照“ISED-F15F1-V8 序号 PDF”文件；
2. 在板子的背面，有 11 个没有元件的长圆孔，要开钢网，做加锡处理，锡的高度不小于 0.2mm ；
3. 有焊接高度要求的元件；
 D5、D14 的管脚高出线路板 8mm 整，并要横平竖直；
 Q2（LKB40N65TM1）的管脚高出线路板 7.3mm，并要横平竖直；
 R157、R189、R190 圆体底部高出线路板 2~3mm；
4. 焊接 U1 时要保证 U1 的上平面 平行于线路板，U1 的管脚本身有自然的卡点，卡点紧贴线路板；
5. 电容 C2 为直插件，焊接前需成型，电容躺平在线路板上 ；
6. 打叉的元件 不焊接；红色方框内的元件不焊接；
7.  图形中的“+”号，表示是电容的正极，焊接时要注意；
8. 未标注的元件，紧贴线路板焊接；
9. 所有焊盘（焊锡）的高度、管脚的高度，均不能超过 2mm，超出一个点，则为不合格品；
10. 未特殊说明的参见《IPC-A-610E 电子组件的可接受性》标准

编制		审核		批准	
日期		日期		日期	